

情况说明

1、基于失效物理的亚微米 TSV 可靠性评价技术研究；2、光电“感、存、算”一体智能芯片技术项目-课题二，红外感算一体芯片研究&课题三，感存算一体化三维集成研究|王玮协作项目。项目编号：（1）8204800773，（2）8201702233，因项目执行过程中基于科研任务、样品加工或产品开发等目的使用乙方微加工与器件平台的超净间及加工测试设备、物料，并支付相应费用；受托方根据需求提供相应的设备机时、设备培训、代理操作、物料提供等服务，并按照相应标准收取服务费用，因预算编制时对外协单位的选择未能列出，所以未体现在预算书中。

现根据实际需求，且经过综合比较其他单位与（此单位名称：联合微电子中心有限责任公司）的测试加工服务，（此单位名称：联合微电子中心有限责任公司）相对符合本次技术服务的所有需求，且收费合理，故选择该单位进行工艺加工。

且声明：本人与（此单位名称：联合微电子中心有限责任公司）无任何关联关系。

负责人（签字）：

2025年04月14日

集成电路学院

11010810160452